



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of "Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service",our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



## Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



2013/09/26 05:06:40 ctanke

DRAWING FOR REFERENCE: This is subject to change without notice

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				

適用規格		JEIDA Ver.4		
定格	使用温度範囲	-55 °C ~ +85 °C	保存温度範囲	-40 °C ~ +70 °C
	電圧(1)	1~68 : AC 125 V	使用湿度範囲	相対湿度95%以下 (ただし、結露しないこと。)
	電流(1)	1~68 : 0.5 A		

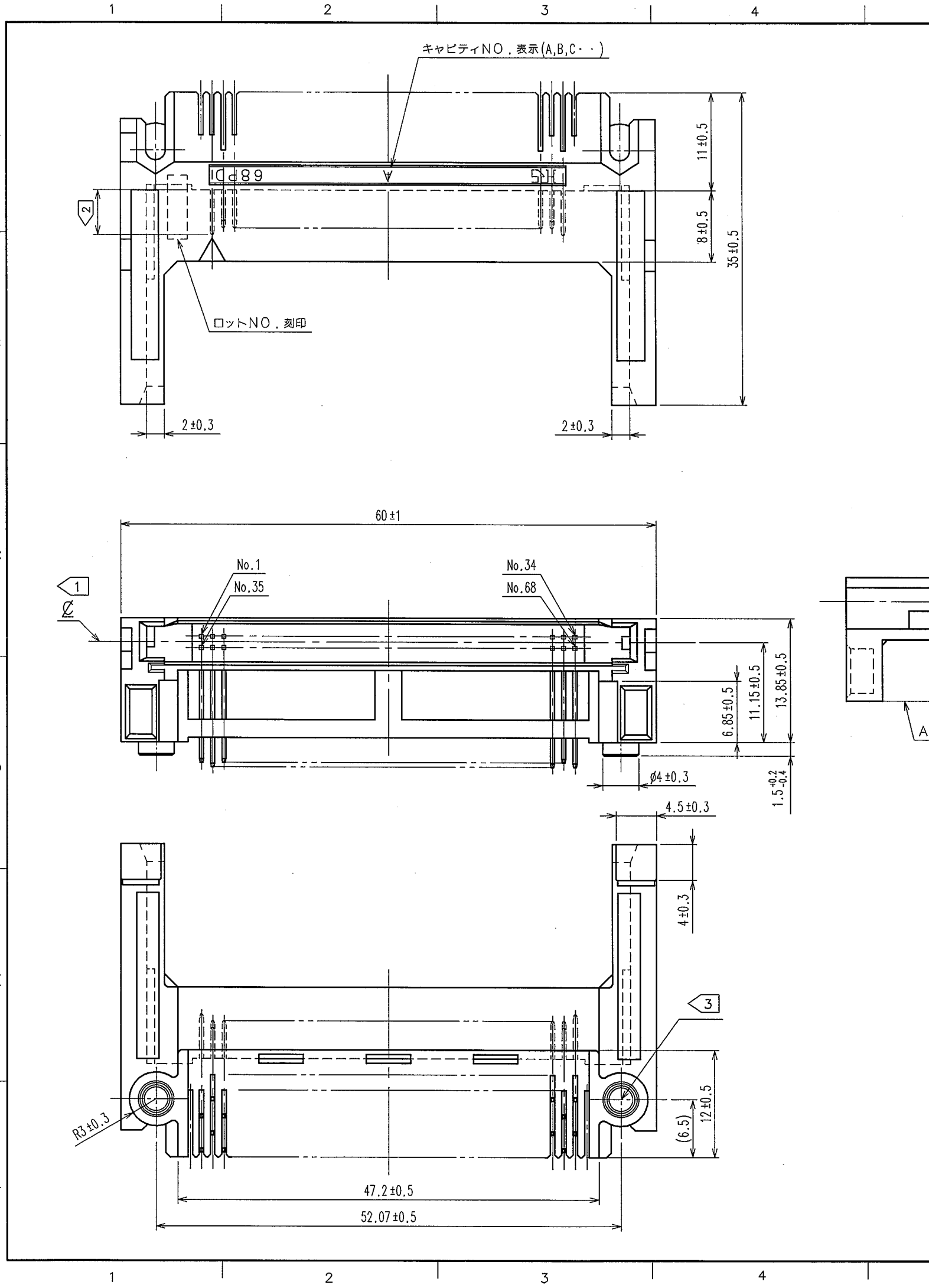
性 能		規 格	QT	AT	
項 目	試 験 方 法				
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電氣的性能	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20 mV 以下、1 mA で測定する。 [MIL-STD-1344A METHOD 3002.1]	40mΩ以下	○	-
	耐電圧 METHOD 301	AC 500Vrmsの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-
	絶縁抵抗 METHOD 302	DC 500Vで測定する。	1000MΩ以上	○	-
機械的性能	挿抜寿命 (オフィス環境)	毎時 400~600回の速度で、10,000回の挿抜を行う。	①接触抵抗: 60mΩ以下 ②極度の摩耗や破損等の異常がないこと。	○	-
	振動・高周波 METHOD 204D	周波数 10~2000Hz、全振幅 1.52mm又は、 加速度 147m/s <sup>2</sup> ( $g$ ) で3方向各4時間の振動を加える。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	衝撃 METHOD 213B	加速度 490m/s <sup>2</sup> 、持続時間 11msの正弦半波で 3方向各 3回の衝撃を加える。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
環境的性能	熱衝撃 METHOD 107G	温度 -55 → +5 ~ +35 → +85 → +5 ~ +35 °C 時間 30 → 最大5 → 30 → 最大5分 で 5サイクルの嵌合放置をする。 (後処理: 室温に1~2時間放置)	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	湿度 (定常状態) METHOD 103B	温度 40±2°C、湿度 90~95%中に96時間の嵌合放置をする。 (後処理: 室温に1~2時間放置)	①絶縁抵抗: 100MΩ以上 ②機能を損なう腐食や破損等の異常がないこと。	○	-
	硫化水素ガス	温度 40±2°C、約80%RH 3ppmのガス中に96時間の嵌合放置をする。(後処理: 室温に1~2時間放置) [JEIDA-38]	機能を損なう腐食や破損等の異常がないこと。	○	-
	塩水噴霧 METHOD 101D	温度 35±2°C、5±1%の塩水噴霧中に48時間の嵌合放置をする。(後処理: 塩の付着物を水洗い後、室温に24時間放置)	機能を損なう腐食や破損等の異常がないこと。	○	-

備考 注(1) 「 ~ 」は端子No.を示す。	製 図 	担 当 	検 図 	承 認 	出 図
----------------------------	---------	---------	---------	---------	-----

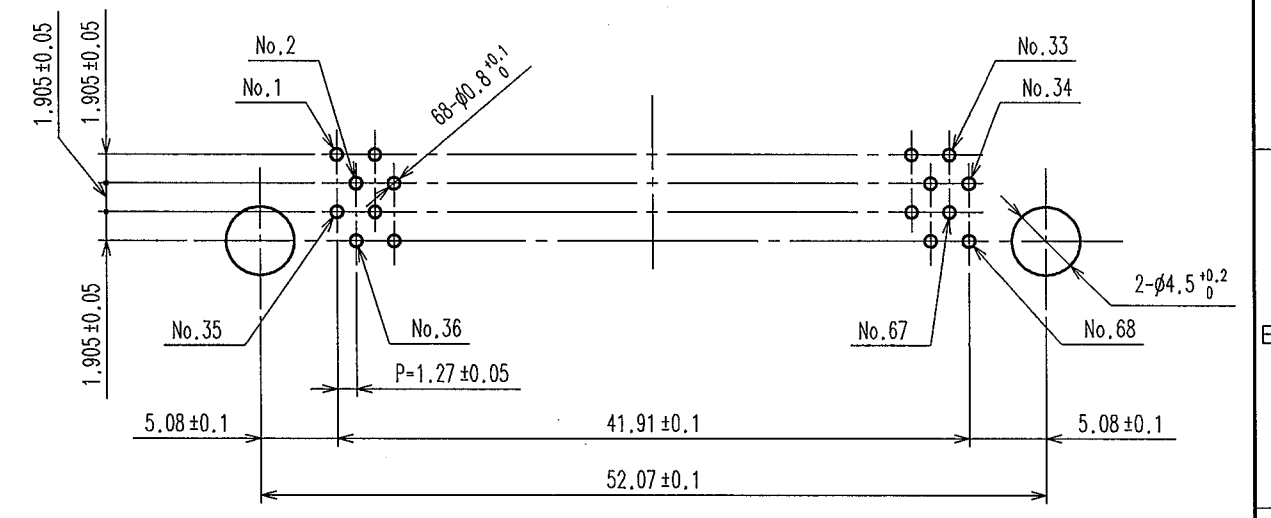
試験規格の記載のない試験方法は MIL-STD-202Fを適用している。		注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目	
<b>HRS</b> ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品規格表	
製品名 IC1FB-68PD-1.27DS(72)		製品コード CL640-0025-0-72	
旧CL CL	図番 SLC4-083623-03	製品コード CL640-0025-0-72	1 1

TO  
PCK

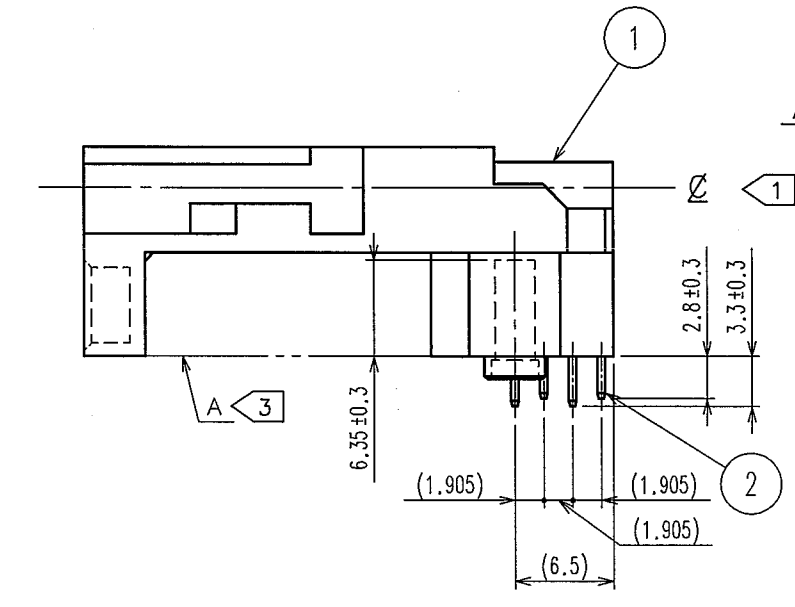




Δの數 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	Δの數 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					△				
△					△				
△					△				



バックボード寸法図(実装面側)



- 注 ① φは3.5%の中心線を示します。  
 ② カード嵌合部の寸法は『PC Card Standard』に準じています。  
 ③ タッピングねじはJIS-B-1007の2種、呼び径3相当で基板上面(A面)より5~6mm突出する様選択して下さい。

2	黄銅	(接触部)Ni2.5μm+Au0.2μm (実装部)Ni2.5μm+Sn2μm
1	PBT樹脂	クワ UL94V-0
部番	材質	処理,備考

備考 REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-083623-03	製品名 PART NO. IC1FB-68PD-1.27DS(72)			
尺度 SCALE 2:1	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL640-0025-0-72			
HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		1/1			

TO
PCK